

半導體工程系 四技 108 學年度入學課程結構規劃表

課程類別		一年級						二年級						三年級						四年級									
		第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期						
		課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數				
校共同必修課程	應修學分數 12學分	實務應用文	2	2	大學國語文	2	2																						
		實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2																
		體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2																
		服務教育(一)	0	2	服務教育(二)	0	2																						
核心通識	應修學分數 6學分 (每領域必修 1門)	海洋科技與文明發展	核心(一)海洋科技探索2/2																										
		生命探索與在地關懷	核心(一)海洋文明發展2/2																										
		創意創新與數位知能	核心(二)生命與倫理2/2																										
			核心(二)在地文化探源2/2																										
博雅通識	應修學分數 10學分 (每群必修 1門)	美感與人文素養	核心(三)創意與創新2/2																										
		科技與環境永續	核心(三)運算與程式設計2/2																										
		社會與知識經濟	博雅通識/學分數/時數																										
		歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																										
跨課程認列		博雅通識/學分數/時數																											
		通識微學分(一)1、通識微學分(二)1																											
專業課程	必修	應修課程數 31門/ 應修學分數 75學分	電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	電子學(一)	3	3	電磁學	3	3	單晶片實驗	2	3	實務專題(一)	2	4	實務專題(二)	2	4						
			微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	工程數學(一)	3	3	電子學(二)	3	3	通訊工程實習	2	3	VLSI設計實習	2	3									
			普通物理(一)	3	3	普通物理(二)	3	3	數位邏輯	3	3	半導體元件(一)	3	3	半導體製程(一)	3	3	半導體量測實驗	1	2									
			普通物理實驗(一)	2	4	普通物理實驗(二)	2	4	電腦輔助電路設計實習	2	4	微電子應用電路實驗	2	4	光電元件量測暨封裝實務	2	3	感測元件應用電路實習	2	3									
			普通化學	3	3	程式語言實習	2	4	微電子電路實驗	2	4	虛擬圖控儀表實務	2	4															
		電路應用實務 2 4 FPGA/HDL設計實習 2 4																											
專業課程	選修	應修學分數 至少 25學分	半導體產業介紹	3	3	科技英文	3	3	向量分析	3	3	通訊工程	3	3	VLSI電路設計	2	2	近代生物學	3	3	工業電子	3	3	自動控制	3	3			
						統計學	3	3	暑期實習-產業實習	3	3	光電半導體元件	2	2	半導體量測	2	2	平面顯示器	3	3	生物感測	3	3	複變函數	3	3			
												IC產業介紹與應用	3	3	感測元件暨電路分析	2	2	新穎氧化膜製程與分析	3	3	發光二極體元件及其應用	3	3	可程式邏輯控制應用	3	3			
												工程數學(二)	3	3	微電子學(三)	3	3	微機電設計	3	3	薄膜技術	3	3	真空技術	3	3			
														半導體技術	3	3	半導體工業英文	3	3	產業經濟學	3	3	工業經濟學	3	3				
														太陽能光電技術	3	3	半導體奈米技術	3	3	訊號與系統	3	3	奈米生醫感測	3	3				
														半導體元件(二)	3	3	數位訊號處理	3	3	微機電製程	3	3	生醫檢測技術	3	3				
														半導體工業	3	3	類比電路設計	3	3	晶品工程	3	3	半導體設備	3	3				
														半導體負電阻元件	3	3	半導體封裝工程	3	3	生醫工程科技	3	3	晶體成長	3	3				
														物聯網產業介紹與應用	3	3	半導體	3	3	近代雷射原理與光電檢測器	3	3	半導體評估技術	3	3				
														太陽能電池製程與應用	3	3	半導體材料科學	3	3	感測網路應用實務	3	3	大數據資料庫應用實務	3	3				
														暑期實習-產業實習	3	3	物聯網產業介紹與應用	3	3	半導體封裝可靠度分析	3	3	半導體封裝可靠度分析	3	3				
																半導體製程技能與實務培訓	3	3	電力系統分析與模擬	3	3	電力系統分析與模擬	3	3					
																電腦輔助微波電路設計	3	3	半導體封裝元件EMI/EMC分析	3	3	半導體封裝元件EMI/EMC分析	3	3					
																醫療儀器系統實務	3	3	液晶平面顯示器	3	3	學期實習-產業實習	9	9					
																半導體製程(二)	3	3	暑期實習-產業實習	3	3	學年實習-產業實習	9	9					
																嵌入式系統實習	3	3	學期實習-產業實習	9	9								
													學期實習-產業實習	9	9	學年實習-產業實習	9	9											
													學年實習-產業實習	9	9														

(接續背面)

備註：

- 一、畢業總學分數為 128 學分。
- 二、必修 75 學分，選修 25 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 28 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、須修滿英(外)語 8 學分，本國籍學生(應用英語系除外)英語畢業門檻為等同 CEFR B1 以上程度之校外英檢成績；或通過校內英語畢業門檻檢定考試。多益成績達 550 分(或等同 CEFR B1 等級)以上者得免修大一英語(4 學分)；多益成績達 785 分(或等同 CEFR B2 等級)以上者得免修大一、大二英語(8 學分)，但須選修主題式英語或其他外語課程補足語言畢業學分數。其他外語課程請參閱外語教育中心課程結構規劃表。
- 五、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 六、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：
  1. 於就學期間，需通過相關專業檢定(證照之張數及類別如下：一張電機、電子類相關證照或二張資訊類相關證照)，附有證明文件，經審查合格，始得畢業。
  2. 「半導體產業介紹」、「向量分析」、「通訊工程」、「光電半導體元件」、「VLSI 電路設計」、「半導體量測」、「感測元件暨電路分析」課程為必修科目。
  3. 承認外系選修學分 9 學分為專業選修(本院非本系開設之專業選修課程至多承認 6 學分，非本院開設之專業選修課程至多承認 3 學分)。
  4. 「學年實習-產業實習」上下學期皆及格者，將列入畢業總學分數，若只有其中一學期及格者，列入專業課程選修學分數，但不列入畢業總學分數。
  5. 「暑期實習-產業實習」、「學期實習-產業實習」、「學年實習-產業實習」，須於畢業前擇一修習，修畢且及格者方可畢業。



111. 1. 20